



LOTPASTE SC 170

ISO 1.2.3.C; RE L0

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC 170 ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle SMT-Anwendungen bestens geeignet ist. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur langjährige Erfahrung auf dem SMT-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.

Die SC 170 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen, **halogenfreien(!)** Bindemittel auf **Kunstharzbasis**, das der RE L0 nach J-STD 004 (F-SW32) oder RMA-Qualifizierung entspricht und dadurch zu den neuesten "no-clean"-Pastentypen gehört. Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

SC 170 Wasserklarer, geringer (4,5%) Rückstand, begünstigt den "in circuit"-Test !

SC 170 Eine wahre "no clean"-Paste

SC 170 Enthält Korrosionsinhibitoren

SC 170 Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang !

SC 170 24 Stunden Standzeit

SC 170 für "fine und super fine pitch" Anwendungen die beste Wahl

SC 170 Einwandfreie Lötresultate mit allen gängigen Lötprofilen

PHYSIKALISCHE DATEN

Metallpulver: bevorzugte Legierungen 62Sn\36Pb\2Ag (SP-179°C), 63Sn\37Pb (183°C) und 10Sn\88Pb\2Ag (SB 268-302°C)

Bezeichnung der Korngröße

Nach SC	nach DIN 32 513	Durchmesser	mesh size
Fein (T3)	Klasse 3	20-45µm	325-500
Superfein (T4)	Klasse 4	15-30µm	400-700

VISKOSITÄT (Pa.s) +/-10% gemessen nach Brookfield RVT-DV-II Viskosimeter bei 90% Metallgehalt:

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	800-1000

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messungen am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	4,4x10 ¹³	6,8x10 ²

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC 170 ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach SN 59650) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 (F-SW 32) „no-clean“ entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können, auch unter dem Schutzlack.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100mm/s.

Merke! Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen. Aus diesem Grund empfehlen wir den **SC Schablonenreiniger**.

Die Lotpaste ist in allen gängigen Reflow-Systemen mit exzellenten Lötgergebnissen zu gebrauchen.

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Flußmittelanteil	Gebindegröße
z.B.	SC 170	T3	62/36/2Ag	10%	500g
z.B.	SC 170	T4	63/37	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn62Pb2Ag / F-SW 32 / 90-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.